

Metal Heater

应用场景

- 半导体制程设备中，如蚀刻设备、化学气相沉积 CVD 设备、物料气相沉积 PVD 设备
- 具备核心仿真能力，优化产品输入功率、流体等关键参数，可提供更高的工艺一致性、稳定性、可重复性

特点和指标

- 仿真设计能力，具备共同开发 heater 能力
- 有电子束焊接设备及真空钎焊设备，具备加热盘焊接能力
- 加热盘装配能力，主要加热丝装配能力



关键参数	VITAL
盘面面粗度	Ra < 0.4μm
平面度	< 0.025mm
垂直度	< 0.05mm
焊接结合率	≥ 95%
温度均一性	< ± 1%
膜厚均一性	± 5%μm
HEATER BANDING	自制
Test Charmber	✓